



平成 30 年5月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成 29 年9月 29 日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 細谷 信明
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部担当 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011
 四半期報告書提出予定日 平成 29 年 10 月 13 日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成 30 年5月期第 1 四半期の業績(平成 29 年6月 1 日～平成 29 年8月 31 日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30 年5月期第 1 四半期	16,194	1.2	1,202	12.7	1,215	23.9	816	23.4
29 年5月期第 1 四半期	16,003	11.6	1,067	1.6	981	△2.6	662	△1.9

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
30 年5月期第 1 四半期	25.42	—
29 年5月期第 1 四半期	20.61	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
30 年5月期第 1 四半期	82,986	56,060	67.6
29 年5月期	79,574	55,637	69.9

(参考)自己資本 30 年5月期第 1 四半期 56,060 百万円 29 年5月期 55,637 百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29 年5月期	—	13.00	—	13.00	26.00
30 年5月期	—	—	—	—	—
30 年5月期(予想)	—	14.00	—	14.00	28.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成 30 年5月期の業績予想(平成 29 年6月 1 日～平成 30 年5月 31 日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	33,500	10.2	2,300	10.7	2,250	11.9	1,530	11.8	47.62
通期	67,000	11.1	4,100	11.1	4,050	11.2	2,730	11.6	84.97

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

30年5月期1Q	35,497,183株	29年5月期	35,497,183株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

30年5月期1Q	3,368,738株	29年5月期	3,368,610株
----------	------------	--------	------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

30年5月期1Q	32,128,477株	29年5月期1Q	32,128,785株
----------	-------------	----------	-------------

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(セグメント情報)	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費に持ち直しの動きが見られるなど、緩やかな回復基調が継続いたしました。

半導体シリコンウエハーは、メモリデバイス向けの需要に加え、ロジックデバイス向けの需要も好調なことから、生産は引き続き高水準で推移いたしました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第1四半期累計期間の売上高は161億9千4百万円と前年同四半期比1.2%の増収となり、営業利益は12億2百万円(前年同四半期比12.7%増)、経常利益は12億1千5百万円(同23.9%増)、四半期純利益は8億1千6百万円(同23.4%増)となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、主力の300mmウエハーを中心として、高水準の生産を継続いたしました。そうした中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。この結果、その他の取扱商品において減収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期会計期間末における総資産は、有形固定資産の増加等により、前事業年度末と比較して34億1千1百万円増加し、829億8千6百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の増加等により29億8千8百万円増加し、269億2千5百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加3億9千9百万円等により、560億6千万円となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成29年7月14日の「平成29年5月期 決算短信」で公表いたしました第2四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成29年5月31日)	当第1四半期会計期間 (平成29年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	26,742	26,702
受取手形及び売掛金	20,512	22,439
商品及び製品	776	226
仕掛品	443	515
原材料及び貯蔵品	1,573	1,497
その他	1,660	1,458
貸倒引当金	△8	△6
流動資産合計	51,699	52,832
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	10,598	14,546
その他(純額)	15,032	13,385
有形固定資産合計	25,631	27,931
無形固定資産	555	514
投資その他の資産		
その他	1,693	1,713
貸倒引当金	△5	△5
投資その他の資産合計	1,687	1,707
固定資産合計	27,875	30,153
資産合計	79,574	82,986
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	14,604	15,414
短期借入金	100	100
未払法人税等	970	261
引当金	62	449
その他	5,453	7,676
流動負債合計	21,190	23,902
固定負債		
長期借入金	300	275
退職給付引当金	1,439	1,415
その他	1,007	1,333
固定負債合計	2,746	3,023
負債合計	23,937	26,925

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成29年5月31日)	当第1四半期会計期間 (平成29年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	22,690	23,090
自己株式	△4,762	△4,763
株主資本合計	55,530	55,929
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	102	127
繰延ヘッジ損益	5	4
評価・換算差額等合計	107	131
純資産合計	55,637	56,060
負債純資産合計	79,574	82,986

(2) 四半期損益計算書
(第1四半期累計期間)

(単位:百万円)

	前第1四半期累計期間 (自平成28年6月1日 至平成28年8月31日)	当第1四半期累計期間 (自平成29年6月1日 至平成29年8月31日)
売上高	16,003	16,194
売上原価	14,305	14,220
売上総利益	1,698	1,974
販売費及び一般管理費	630	771
営業利益	1,067	1,202
営業外収益		
受取利息	1	0
受取配当金	4	4
その他	6	13
営業外収益合計	12	18
営業外費用		
支払利息	0	0
為替差損	98	5
その他	0	0
営業外費用合計	98	5
経常利益	981	1,215
特別利益		
固定資産売却益	1	3
特別利益合計	1	3
特別損失		
固定資産売却損	—	0
固定資産除却損	8	26
その他	28	—
特別損失合計	36	26
税引前四半期純利益	945	1,192
法人税、住民税及び事業税	101	194
法人税等調整額	181	181
法人税等合計	283	375
四半期純利益	662	816

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高に関する情報
前第1四半期累計期間(自 平成28年6月1日 至 平成28年8月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	6,017	9,985	—	16,003	—	16,003
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	—	545	545	△545	—
合計	6,018	9,985	545	16,549	△545	16,003

当第1四半期累計期間(自 平成29年6月1日 至 平成29年8月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	6,980	9,214	—	16,194	—	16,194
セグメント間の内部売上高 又は振替高	13	—	999	1,013	△1,013	—
合計	6,994	9,214	999	17,208	△1,013	16,194